



# Rémy Turpin

**Engineering Director — FinTech, Scale & Delivery**

France remy.turpin@gmail.com 06 58 81 79 04 [linkedin.com/in/remyturpin](https://linkedin.com/in/remyturpin)

## À PROPOS

Engineering Director avec **10+ ans d'expérience dans la FinTech**, spécialisé dans le **scaling d'équipes** techniques (jusqu'à ~70 collaborateurs) et la transformation organisationnelle.

Expert en delivery produit, **architecture scalable** et **leadership technique**.

Réalisations majeures : Core Banking System, refonte KYC/onboarding, intégration de nouveaux moyens de paiement, convergence post-fusion.

## EXPÉRIENCE

### Payplug — Paiements (2014 - 2025 - 11 ans)

#### Engineering Director

2022 — 2025

- Pilotage de 2 tribes (Finance, Onboarding & Merchant Experience) : 6 squads, ~40 collaborateurs, 2 niveaux de management
- **Réalisations** : Core Banking System, refonte export, optimisation parcours marchand
- Roadmap annuelle / trimestrielle (MoSCoW), observabilité Datadog, POC IA internes pour amélioration process et code
- Pilotage de la restructuration post-fusion (avec Dalenys) et de la montée en puissance des équipes tech dans un contexte de forte croissance.
- Management et formation de 5 Engineering Managers
- Pilotage au sein du Management Committee (*Produit, Eng, Data, Ops, etc.*)

## Head of Engineering

2020 — 2022

- Responsable du périmètre fonctionnel des 3 tribes (Paielements, TPE & App mobile, Onboarding) : ~70 collaborateurs
- Scaling rapide (35→70 collaborateurs), création de niveaux intermédiaires de management
- **Réalisations** : Intégration nouveaux moyens de paiement (Amex, ApplePay, Bancontact, Sofort, iDeal), refonte KYC/onboarding, parcours omnicanal marchand
- Organisation des équipes en tribes et squads (*avec CTO, Head of Product notamment*)

## Lead Developer → Engineering Manager

2016 — 2019

- Premier Lead puis premier Engineering Manager : création et structuration des premières squads applicatives
- Mise en place des processus de management, delivery et qualité
- Développement du cœur système de paiement, optimisation UX page de paiement

## Ingénieur Développeur Fullstack

2014 — 2016

- Dév. cœur applicatif & APIs paiement (Python, PHP, AngularJS, PostgreSQL)
- Focus performance, sécurité, qualité

---

## Dolead

### Ingénieur d'étude Informatique

2012 — 2014

- Développement plateformes d'affiliation, SEO, publicité ciblée (Python/Flask, PHP, MySQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch)
- Méthodologies agiles (Scrum/XP), qualité code (PEP8, tests unitaires)

## PROJETS & IMPACT

- **Refonte du Core Banking System** : architecture scalable supportant x10 du volume prévu, avec conformité et fiabilité.
- **Convergence post-fusion Payplug & Dalenys** : unification des plateformes, réduction des doublons, optimisation des coûts et cohérence produit.
- **Parcours omnicanal marchand** : expérience utilisateur optimisée pour les paiements en ligne et en magasin, augmentation du taux de conversion.

- **Intégration de nouveaux moyens de paiement (Amex, Apple Pay, Bancontact, Sofort, iDeal)** : meilleure couverture de marché et simplification de l'expérience marchands.
- **Observabilité unifiée (logs, métriques, traces)** : réduction des incidents majeurs et MTTR réduit à 30 minutes grâce à l'observabilité et monitoring actif.
- **CI/CD et feature flags** : accélération des mises en production de 50 % (plus petits et plus rapides), avec sécurité et rollbacks faciles.
- **Programme dette technique** : 20 % de la capacité des équipes dédiée chaque trimestre, tout en maintenant le delivery.
- **Promoteur de l'IA en interne** : assistance au code (Github Copilot, Cursor, Gemini, ...), analyse qualité et optimisation des process pour accélérer l'impact des équipes et renforcer la fiabilité produit.

## COMPÉTENCES CLÉS

Leadership 70+

Product Delivery

Observabilité

Coaching Managers

Tech Debt

DDD / Architecture

Micro-service

CI/CD Automation

## ÉDUCATION

**Master — SUPINFO**

École d'ingénierie informatique

2012

## INFOS

- **Disponibilité** : Janvier 2026
- **Rôles visés** : Director / Head of Engineering
- **Localisation** : France
- **Rythme** : Hybride ~50% Télétravail
- **Langues** : Français, Anglais pro
- **Références** : Sur demande